

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

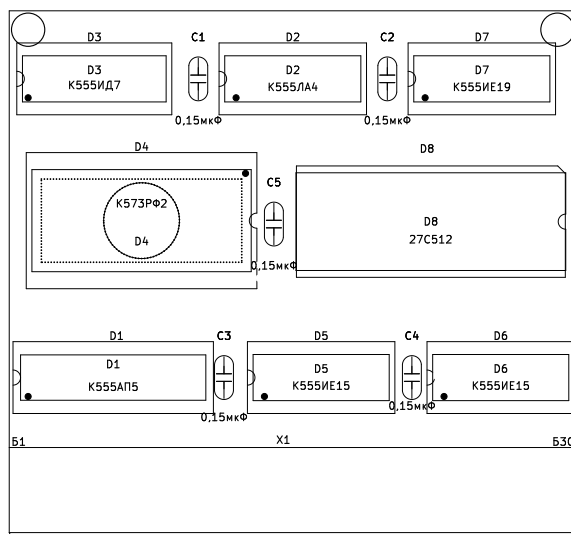
Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Инв.№ подл.

AGAT ROM v2



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТЫ

Количество слоёв меди:	2	Толщина платы:	1,6000 mm
Габариты платы:	75,0000 mm x 70,0000 mm		
Мин. дорожка/зазор:	0,2000 mm / 0,0000 mm	Мин. сверло:	0,3000 mm
Покрытие меди:	Immersion tin	Контроль импеданса:	Нет
Периферийные полу-отверстия:	Нет	Метал. торцы:	Нет
Краевой соединитель:	Да, с фаской		

Имя слоя	Тип	Материал	Толщина (мм)	Цвет	Отн.диэл.прон.	Танг.угла диэл.потерь
F.Silkscreen	Top Silk Screen	Not specified	0 mm	White	1	0
F.Paste	Top Solder Paste		0 mm		1	0
F.Mask	Top Solder Mask	Not specified	0,01 mm	Green	3,3	0
F.Cu	copper		0,035 mm		1	0
Диэлектрик	core	FR4	1,51 mm	FR4 natural	4,5	0,02
B.Cu	copper		0,035 mm		1	0
B.Mask	Bottom Solder Mask	Not specified	0,01 mm	Green	3,3	0
B.Paste	Bottom Solder Paste		0 mm		1	0
B.Silkscreen	Bottom Silk Screen	Not specified	0 mm	White	1	0

AGAT ROM v2

Модуль ПЗУ

Лит. | Масса | Масштаб


Лист 1 | Листов 1

nopmeister@gmail.com